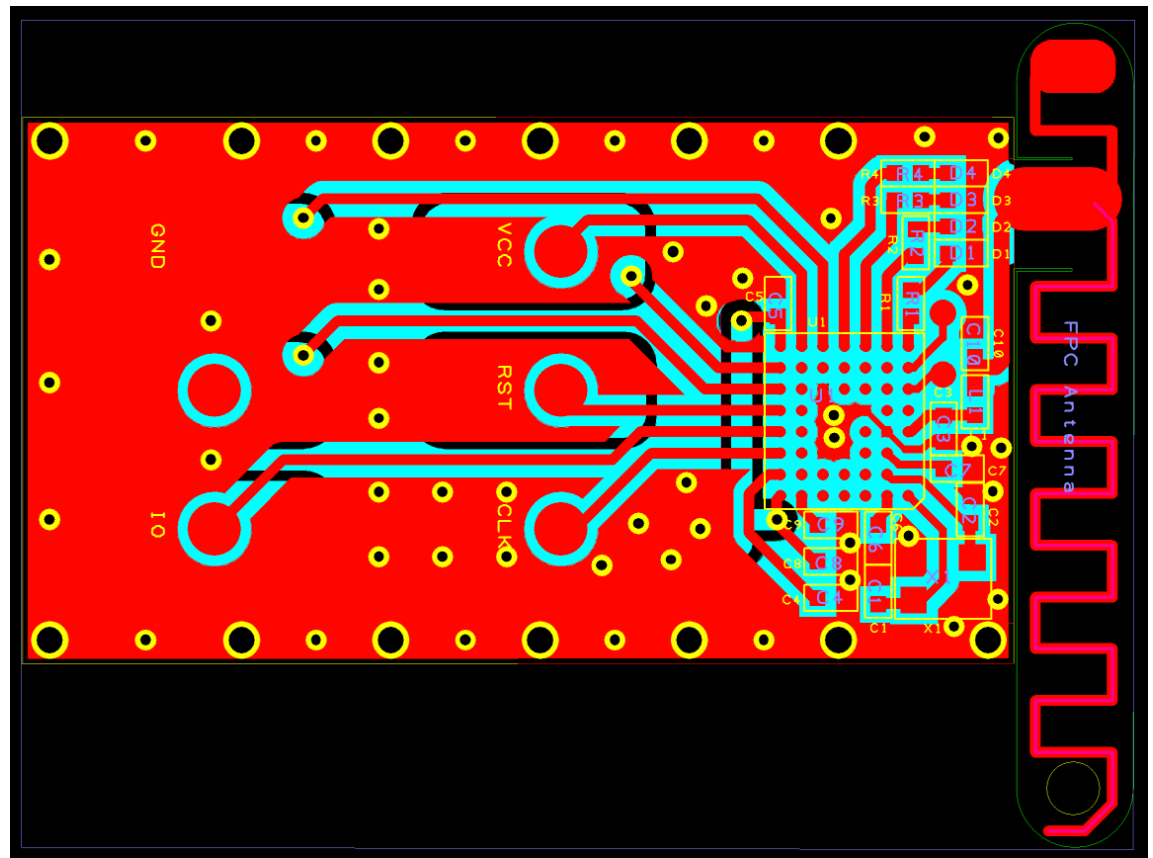


Wireless SIM 样板制作说明

电路板模型示意图



定位孔

电路板贴片部分

FPC天线部分和
电路板连接部分

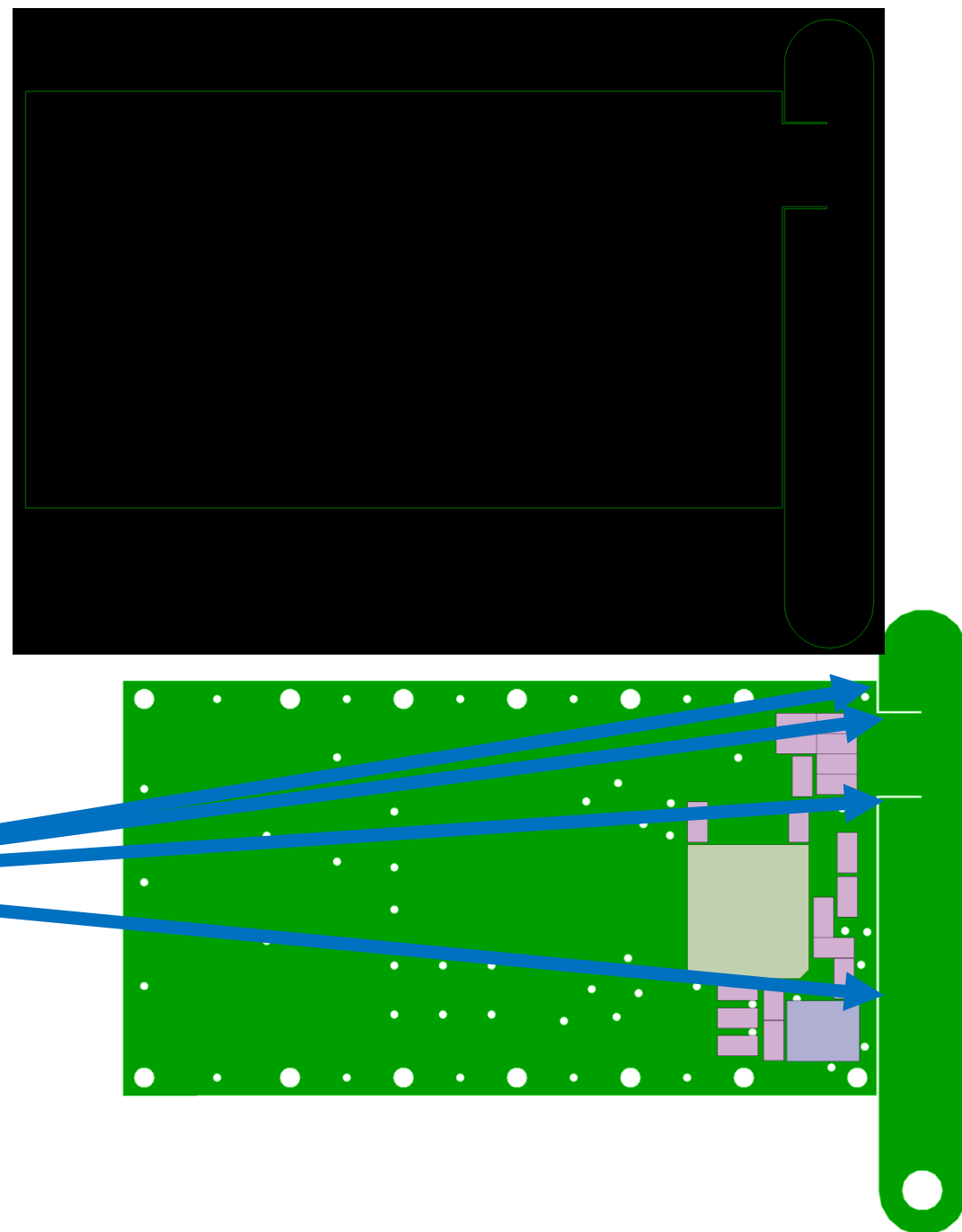
取卡孔

FPC
天线部分

FPC Antenna

FPC天线板切割线(1)

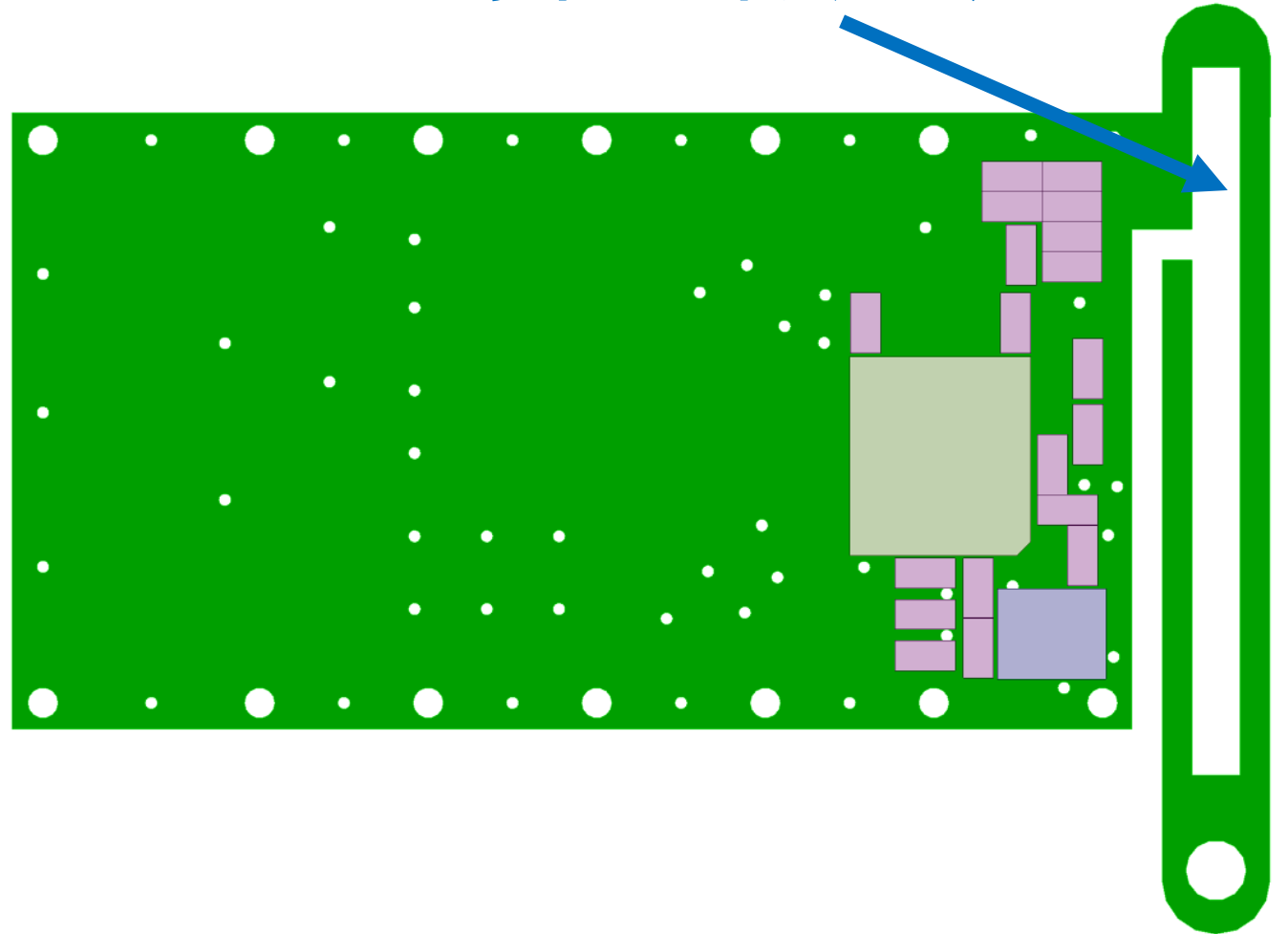
- FPC天线最后需要折叠弯曲，固定在定制的SIM卡托上。天线FPC垂直于原来的电路板，竖直固定在SIM卡托的外侧
- 在切割FPC板外形的时候，天线FPC板和主电路板之间的分离距离是0.05mm，实际上只需要切割一条线分开就可以了



FPC天线板切割线(2)

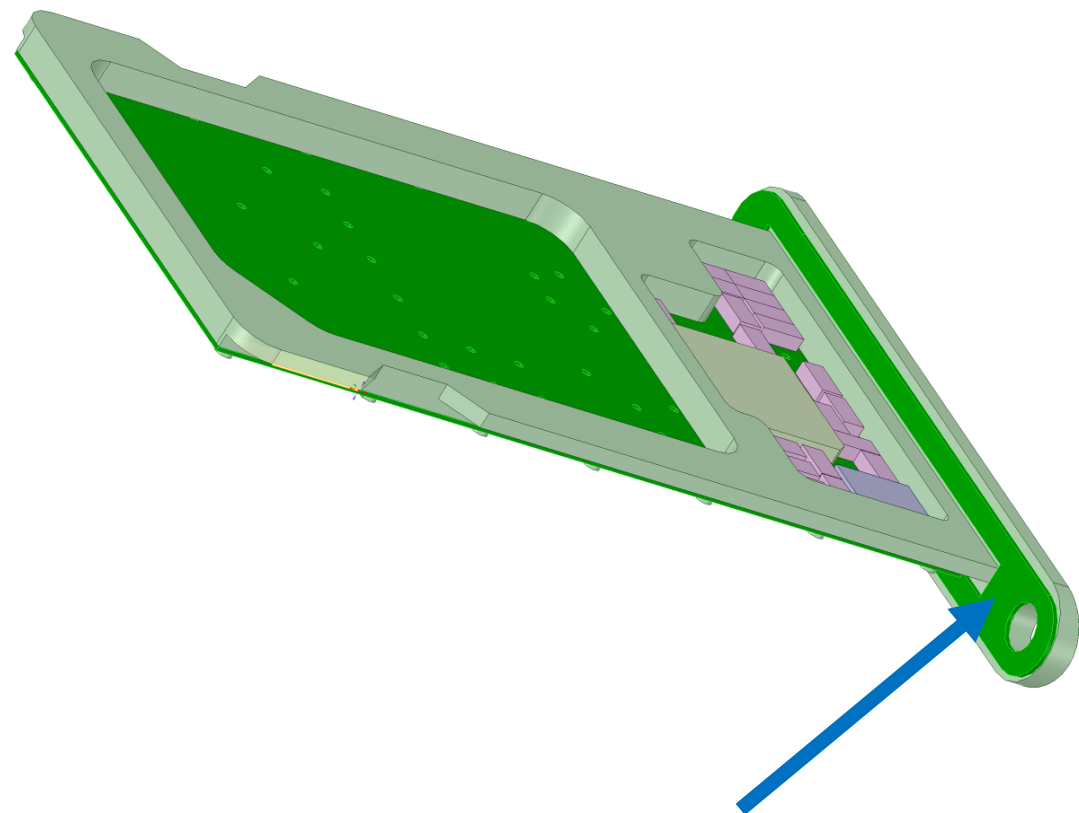
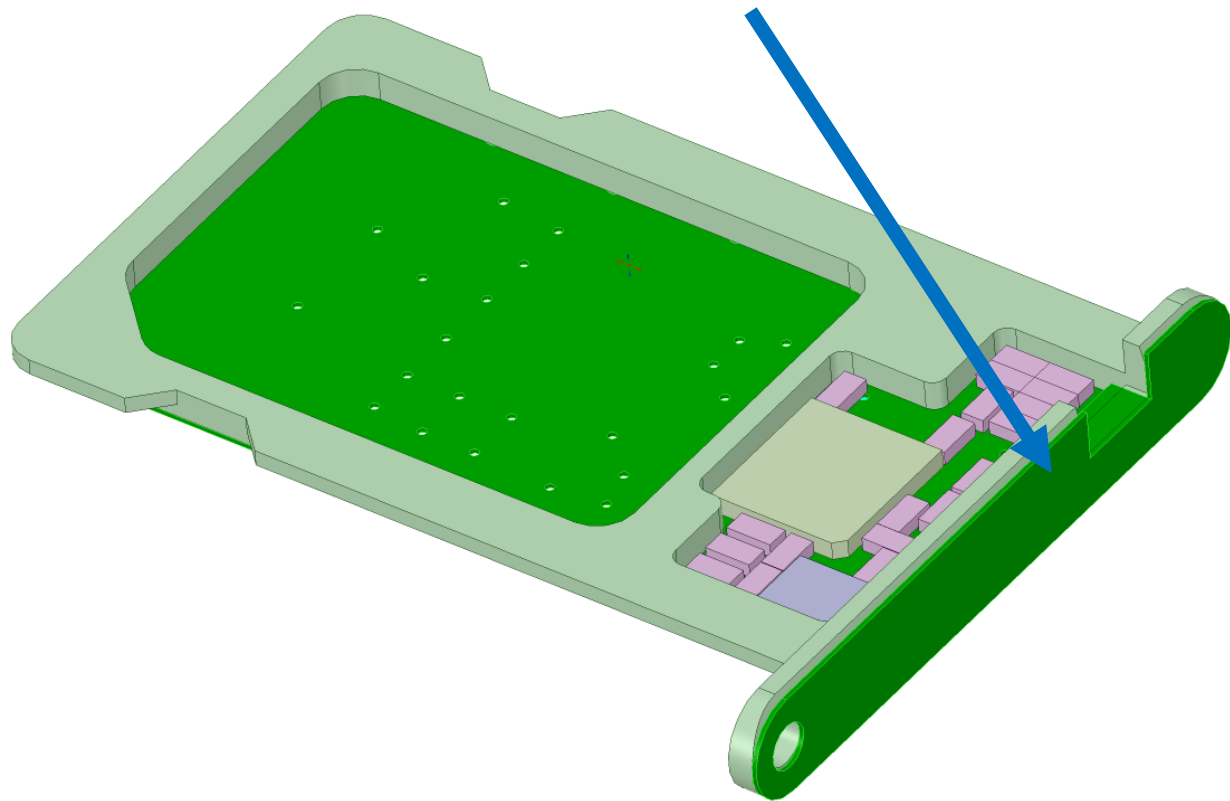
- 另外一个FPC天线最后需要折叠弯曲，固定在定制的SIM卡托的内侧，按照电路板的外形切割就可以了。

FPC天线子板按照电路板的外形切割就可以了



FPC天线固定在定制卡托上的效果

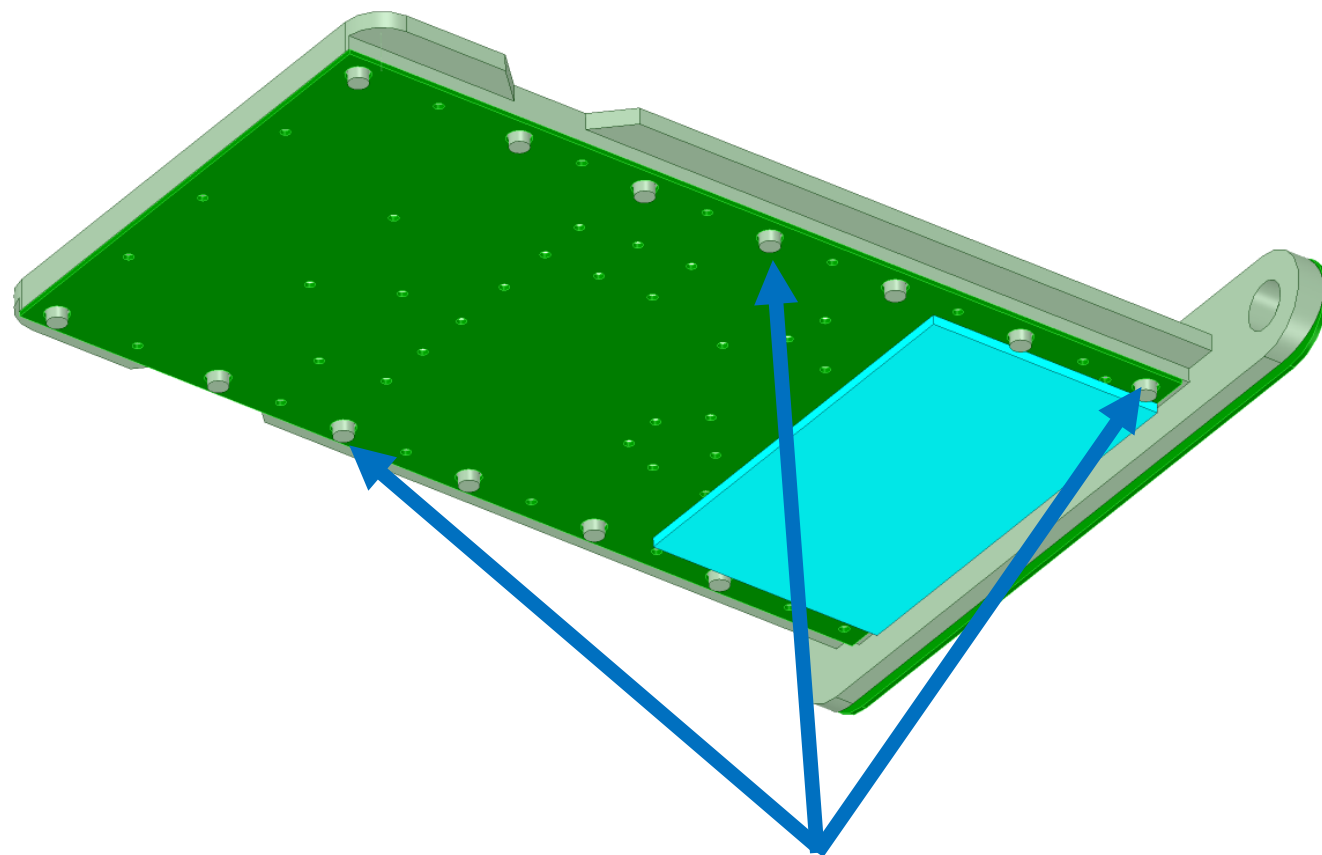
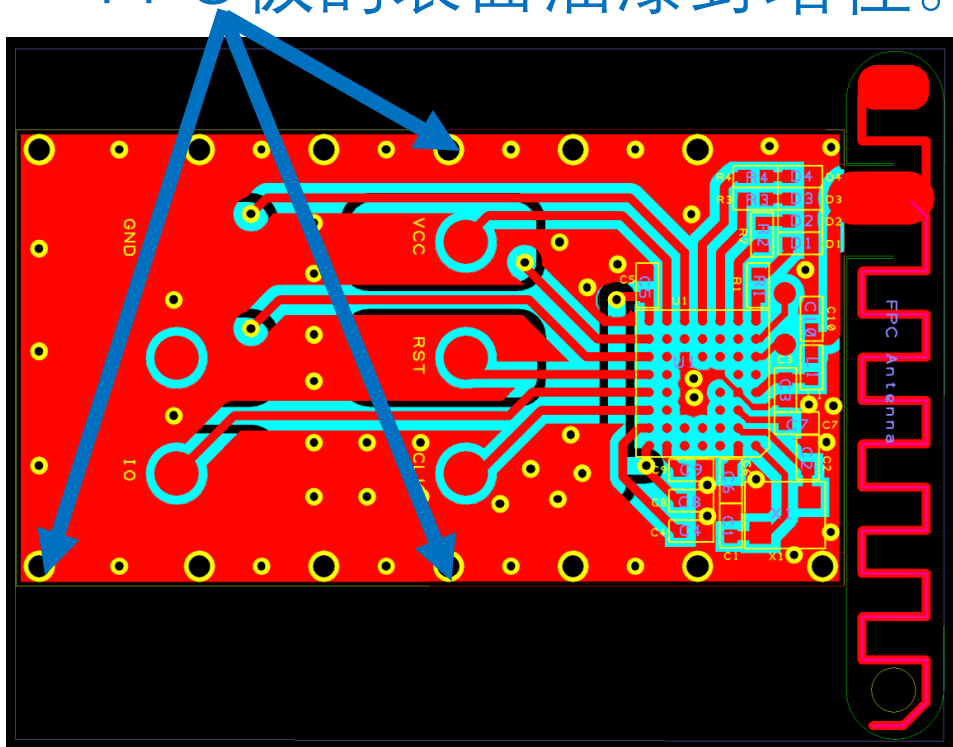
FPC天线子板固定在定制卡托的外侧



FPC天线子板固定在定制卡托的内侧

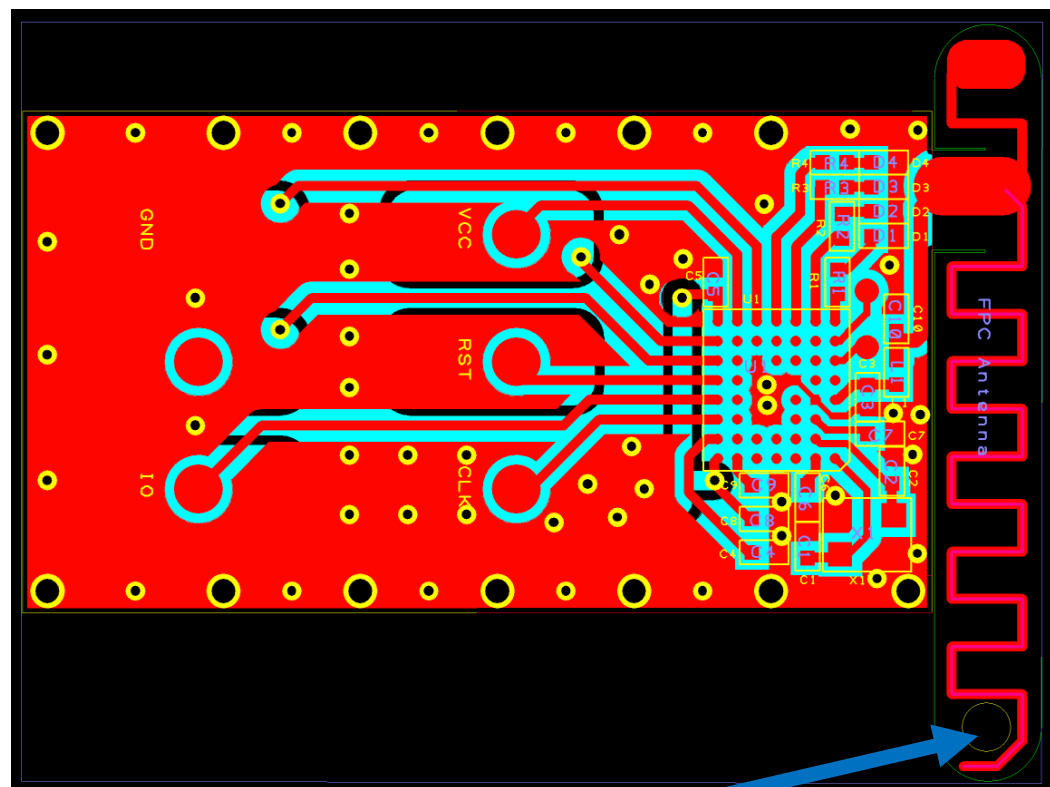
定位孔

电路板上的内径为0.5mm的过孔同时兼做定位孔，成品板应为通孔，特别注意最后不要被FPC板的表面油漆封堵住。



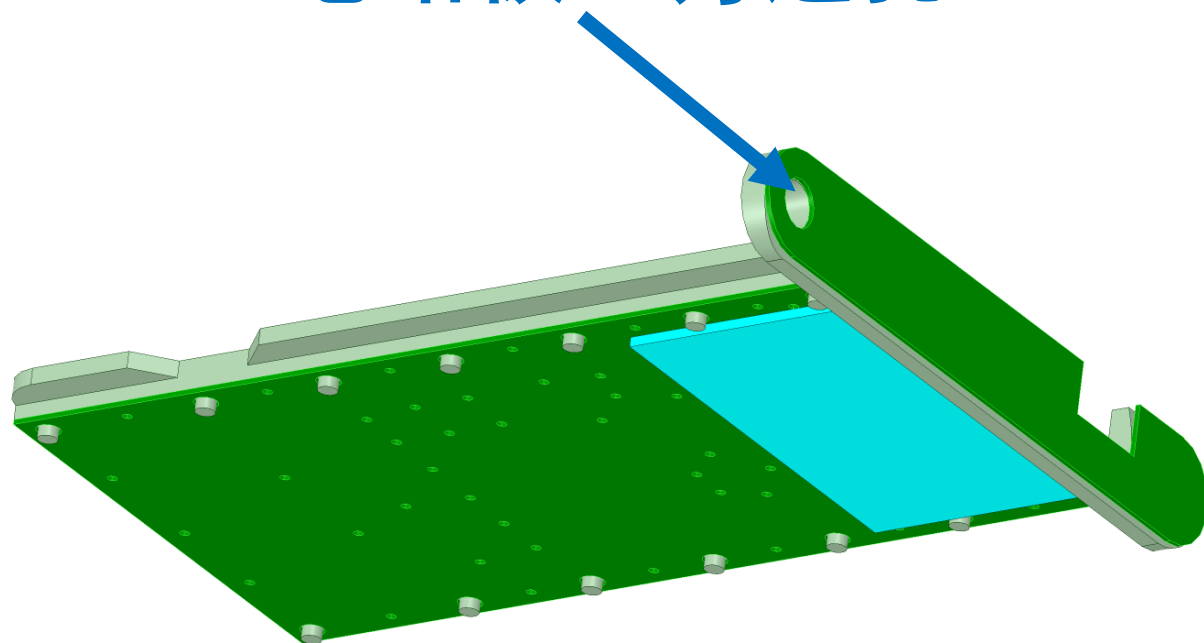
过孔在结构上
兼做定位孔

取卡孔



取卡孔的内径和外径都是1mm,成品板为通孔就可以,不具有电气连接作用。不要被FPC板的表面油漆封堵住

取卡孔在成品电路板上为通孔



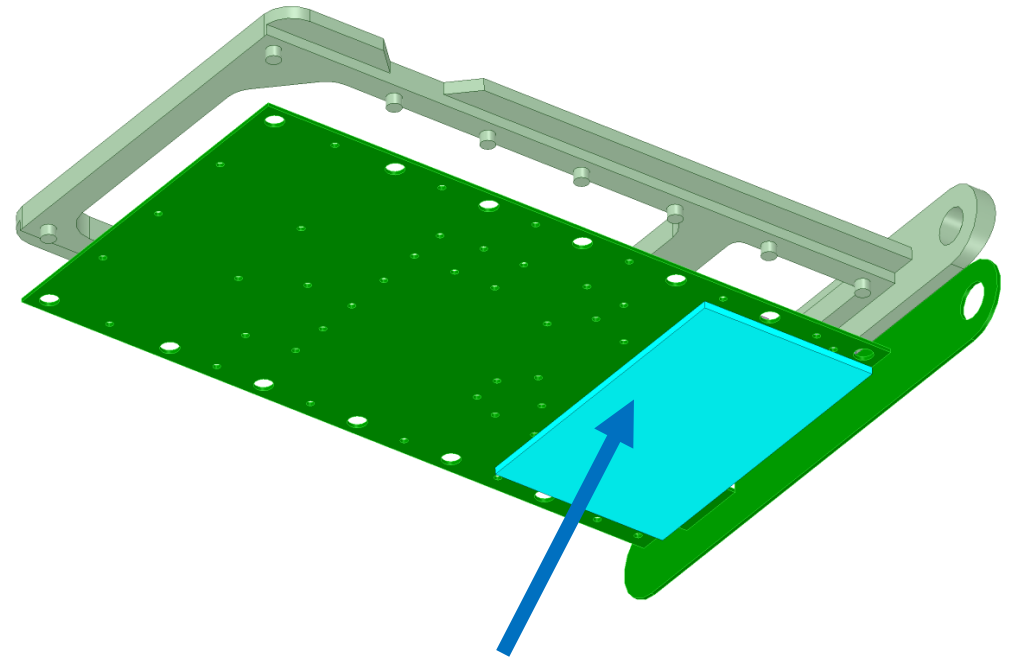
结构加强板(1)

- 贴元件部分电路板的结构加强板为 $5.5\text{mm} * 8.7\text{mm}$ ，厚度为 0.2mm
- 结构加强板的位置在文件* - **Bottom Documentation.gbr**中

结构加强板的尺寸为 $5.5\text{mm} * 8.7\text{mm} * 0.2\text{mm}$ ，在电路板的右边靠边，上下各留 0.77mm 的空隙



Structure Board



结构加强板的尺寸为 $5.5\text{mm} * 8.7\text{mm} * 0.2\text{mm}$ ，在电路板的右边靠边，上下各留 0.77mm 的空隙

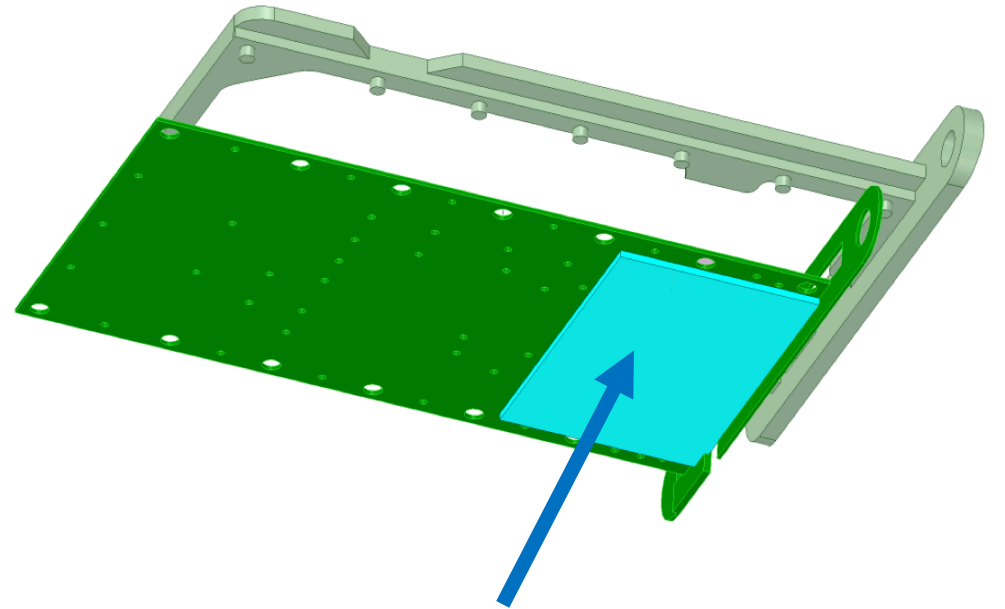
结构加强板(2)

- 贴元件部分电路板的结构加强板为 $5.5\text{mm} * 8.7\text{mm}$ ，厚度为 0.2mm
- 结构加强板的位置在文件* - **Bottom Documentation.gbr**中

结构加强板的尺寸为 $5.5\text{mm} * 8.7\text{mm} * 0.2\text{mm}$ ，在电路板的右边靠边，上下各留 0.77mm 的空隙



Structure Board



结构加强板的尺寸为 $5.5\text{mm} * 8.7\text{mm} * 0.2\text{mm}$ ，在电路板的右边靠边，上下各留 0.77mm 的空隙

其它事项

- 由于电路板比较小，位置丝印和文字丝印都不要印上